

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

# 芯联集成电路制造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-013

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）  |
| 参与单位名称        | 申万证券、中信证券、中泰证券、泓德基金、嘉实基金、路博迈基金、浦银安盛基金等多家机构   |
| 时间            | 2024年10月29日 10:00-11:00  |
| 地点            | 线上会议   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、总经理：赵奇<br>财务负责人、董事会秘书：王伟<br>芯联动力董事长：袁锋  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司领导介绍三季度业绩与经营情况：</p> <p>（一）公司三季度业绩和重要事项进展情况介绍</p> <p>从营业收入来看，公司前三季度实现营业收入45.47亿元，同比增长18.68%；单季度看，第三季度实现营业收入16.68亿元，同比增长27.16%。</p> <p>从盈利能力来看，公司前三季度归母净利润为-6.84亿元，同比减亏6.77亿元，减亏49.73%；EBITDA达到16.60亿元，同比增长92.65%。另外，公司三季度迎来了毛利率拐点，单季度毛利率实现转正，达到6.16%。</p> <p>公司营收保持稳健增长，整体盈利能力持续向好，主要基于：</p> <p>第一，公司SiC、12英寸硅晶圆等新产品快速转化促进收入提升，规模效益和技术优势逐渐显现。受益于新能源车及消费市场的回暖，公司产能利用率逐步提升。同时，不断通过技术迭代和技术创新，实现技术的领先性和丰富化，并在这些领先和丰富</p> |

的技术上实现更大的生产规模，贡献更大的营收。公司SiC、12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，促进公司营业收入快速上升。

第二，公司继续增强精益生产管理能力和供应链管理、成本控制能力等，大幅提升公司产品的市场竞争力。

在资本市场中，公司的回购事项和并购重组事项相关进展如下：

回购事项：公司在9月30日实施完成了股份回购，累计回购公司股份约1亿股，成交总金额约4亿元，回购股份将主要用于股权激励。根据公司审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司将向符合条件的激励对象授予9,166.40万股第二类限制性股票。在激励计划中，公司对员工股权激励设定了2024年相应的营业收入业绩目标。公司非常有信心超额完成全年的营收和减亏目标。同时，2026年的业绩目标是营业收入实现100亿元。

并购重组事项：公司收购芯联越州72.33%股权事项的相关议案于2024年9月20日经公司临时股东大会审议通过。通过本次交易，一方面可一体化管理公司17万片/月8英寸硅基产能，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现更深层次的整合，进一步提升公司效率；更为重要的是，公司可以利用积累的技术优势、客户优势和资金优势，重点支持SiC MOSFET、高压模拟IC等更高技术产品和业务的发展。本次交易完成后，上市公司将协调更多资源在碳化硅领域重点投入，把握汽车电子领域碳化硅器件快速渗透的市场机遇，持续推进产品平台的研发迭代。

## （二）公司三季度业务经营情况介绍

公司致力于打造新能源、智能化产业核心芯片的系统代工平台，坚持技术与市场双轮驱动。在半导体市场竞争日趋激烈的情况下，公司通过持续的研发投入和快速的技术迭代，为客户提供更高性价比和质价比的系统代工服务，持续巩固公司在IGBT、SiC、MEMS等市场的优势地位，并且在模拟IC领域，以高压、大功率的BCD平台进行差异化竞争，赢得市场和客户。

从下游领域看：

第一，在汽车领域，公司不断对芯片代工的工艺平台进行升级推新，保持国内领先地位。在功率模块方面，公司的优势地位正在逐步强化，SiC功率模块已在多家整车厂量产，SiC和IGBT芯片及功率模块持续获得的定点项目能够支持公司未来两到三年的快速增长。根据NE时代数据，公司累计出货功率模块同比增长超5倍。在模拟IC方面，公司拥有多个国内唯一或国内稀缺的BCD工艺平台。同时，公司携手多家优秀的设计公司，车规高压BCD120v和BCD SOI平台代工的产品获得车企多个项目定点。

第二，消费电子领域需求维持高位，消费电子收入季度环比提升。公司最新一代高性能麦克风搭载全球头部手机旗舰机，是国内唯一一家实现量产的代工企业；智能功率IPM模块平台已基本实现完整布局，覆盖空冰洗、商用、厨电、车载压缩机等领域，在各大家电终端逐步上量，客户覆盖率进一步扩大。

**第三，工控领域出现恢复性增长。**公司在工控领域上持续进行技术研发，最新推出的SiC功率模块获得多个储能客户导入。持续推出应用于大功率地面站光伏、风电和储能应用领域的新一代高性能和高可靠性先进产品，预计随后陆续进入大规模量产。数据中心业务上，AI服务器相关应用的电源产品导入持续增加，进一步扩大客户覆盖度。公司应用于 AI 服务器的多相电源的0.18um BCD工艺产品已实现量产且量产规模持续扩大；用于集成 DrMOS 的AI服务器电源管理芯片55nm BCD 20V工艺平台已获重大项目定点。

**展望四季度，公司稼动率将继续保持高位运行，SiC产能将继续爬升，模拟IC平台量产继续推进。公司车载、消费、工控三大领域收入也将继续保持增长态势。结合功率模块等业务放量节奏，预计四季度收入将再攀高峰，同时公司将继续加强内部成本管控，努力提升经营质量，进一步提升公司的盈利能力，超额完成全年的营收和减亏目标。**

## 二、现场交流：

问题1：公司前三季度业绩表现不错，单季度收入持续创历史新高，毛利率实现转正，净利润也实现同比大幅减亏。请问四季度各项业务发展趋势如何？对于未来几年发展前景，包括三大增长曲线的增长趋势、收入结构等的如何展望？

### 回复：

公司前三季度同比增长约19%，第三季度收入突破16亿元，创下了历史新高。展望四季度，新能源汽车的渗透率继续保持增长态势；消费电子行业受益需求复苏和AI新品推动；工控领域尤其是光伏市场供需关系逐步改善，供给端库存出清进入尾声。四季度，公司车载、消费、工控三大领域收入将继续增长，且结合功率模块等业务放量节奏，预计四季度收入将持续创新高。公司有信心超额完成全年的营收和减亏目标。

受益于新能源汽车产业推动下的蓬勃发展，硅基功率器件作为公司第一增长曲线已持续实现高增长；以SiC MOSFET芯片及模组产线组成的第二增长曲线将继续保持国内领先地位，推动业绩持续增长，预期全年实现10亿元收入的目标；以高压、大功率BCD工艺为主的模拟IC方向的第三增长曲线将迎来放量，推动公司未来收入的可持续增长。公司在功率和模拟IC方面的布局逐步完善，助力公司进一步向一站式数模混合芯片系统代工平台转变。

另外，公司在功率领域的模组代工能力已达到国内领先水平，凭借芯片+模组在同一主体内生产制造的优势，更快响应客户、更快辅助客户迭代产品，模块业务收入占比中也将继续上升。

作为半导体产业界的创新科技公司，公司致力于成为全球数模混合芯片的系统代工平台，围绕新能源、智能化所需的芯片进行全面布局。基于三条增长曲线一起发力，公司有信心努力保持未来几年收入每年实现双位数增长，从而实现股权激励计划中2026年

收入突破100亿元的业绩目标。利润方面，随着收入规模的增长、成本的有效控制，2024年将实现净利润大幅减亏。

问题2：公司今年以来SiC业务的盈利变化趋势？明年8英寸SiC量产，公司对价格和市场的未来发展如何展望？

回复：

碳化硅产业链从衬底、外延、器件制造、模块封装各环节良率和价格的进一步优化，是产业进入大生产阶段的必然历程。具有价格和技术竞争力的产品才能拓展更大的市场，支持产业整体的健康发展。在SiC业务各环节中，芯片制造环节整体资金投入更大、科技水平要求更高。今年以来，公司不断扩大量产优势、持续进行技术迭代，研发出性能指标具备全球竞争力的产品，同时逐步提升以模组形式交付的订单，以此提高公司SiC产品的附加值，保持良好的竞争优势和产品盈利能力。

明年8英寸SiC MOSFET产品的量产，由于面积扩大、单片上附载芯片数量增加，从而使单片SiC晶圆产品之价值的提升大于其单片生产成本的增加。随着碳化硅产业链各环节良率不断提升、衬底尺寸从6英寸转8英寸、器件结构从平面转沟槽等一系列的技术进步后，将进入合理竞争和供应集中化的态势。

目前，公司在汽车领域累计获得25个Design win，同时，SiC功率模块在多家整车厂实现量产，这些将为公司2025年、2026年碳化硅业务收入的持续快速增长提供有力的支持。

问题3：公司发布了多个高压BCD平台，主要面向的下游客户有哪些，未来的订单释放节奏如何？明年模拟IC收入的结构，主要来自哪些领域的客户贡献？以及模拟IC明年的扩产计划如何？

回复：

公司的BCD平台，主要应用于汽车、新能源、高端工控、物联网等领域，为其提供完整的高压、大电流与高密度技术的模拟和电源方案，可提供国内稀缺的BCD120V车规G0工艺平台和55nm BCD工艺平台，其应用覆盖车规、高端工控及计算中心领域。

高压 BCD SOI的集成方案工艺平台，具备高性能和高可靠性，应用于车载BMS AFE即电池采样芯片，已经获得重要车企定点。数模混合嵌入式控制芯片制造平台BCD60V/120V+eflash 集成方案工艺平台，致力于节点控制器和SBC等应用，可实现系统高集成的 SOC 解决方案。

在模拟IC方面，公司与国内外优秀的模拟类设计公司进行深度、坚定的合作，目前的合作覆盖了国内优秀模拟类设计公司60%以上。同时，在车规领域和数据中心领域，公司也与国内外具备设计能力的终端客户有着紧密的合作。

自2023年以来，公司陆续发布了十余个国内稀缺或国内领先的BCD工艺平台，公司

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>的差异化竞争优势更加明显。目前，公司已经获得多个客户的订单，今年开始陆续供货，预计2025年将有显著的增长。</p> <p>目前，公司12英寸的产能已达3万片，公司会根据市场需求和定点状况进行适时扩产，在公司前期投资已在逐步出折旧的大背景下，整体投入将保持在可控水平。</p> <p>问题4：公司在车规功率模组市场的份额快速提升，预计未来2-3年公司在模组市场份额达到多少？预计未来收入结构中模组的收入占比能够达到多少？模组业务的毛利率处于什么水平？</p> <p>回复：</p> <p>根据NE时代数据，1-9月新能源乘用车IGBT功率模块国产供应占比超过70%。公司累计出货功率模块91万块，同比增长557%，市占率由2023年的4%提升至8.2%。</p> <p>随着头部客户以及国产替代需求的增加，国产功率模块企业迅速发展，国产功率模块综合竞争力进一步提升，车载功率模组市场的集中化更加明显。公司凭借技术创新、品质提升以及更好的性价比优势，成功进入国内大部分新能源主流品牌。根据公司目前已获得的新车型的定点，在未来2-3年，公司在功率模组市场份额将会有很大的提升空间。</p> <p>2023年公司收入结构中，模组收入占比大概8%。今年公司模组收入预计将翻倍，尤其是在Q4会大幅起量，预计全年模组收入占比有望超过10%。系统代工业务（指晶圆代工+模组业务）相比纯晶圆代工具有更高的附加值，也有利于公司更好地理解客户的需求和应用场景，更好地为客户实现一站式系统代工服务，从而提升客户粘性。</p> <p>问题5：公司6英寸/8英寸SiC MOSFET的产能情况如何，以及明年产能达成情况？8英寸SiC MOSFET产品单片面积增大带来的价值上升是否能超过目前6英寸SiC衬底价格下降的幅度？</p> <p>回复：</p> <p>公司6英寸SiC MOSFET的产能目前已达到8000片/月，产线满载生产中；8英寸SiC MOSFET产线目前处于工艺和产品验证阶段，已有1000-2000片/月的验证用产能。</p> <p>鉴于公司8英寸SiC MOSFET产品的验证进度和验证结果优于预期，2025年公司将在8英寸SiC进入量产后，按市场需求继续扩充8英寸的产能。具体明年的产能数据，公司正在与多家客户预测、讨论中。</p> <p>目前6英寸SiC MOSFET产品已处于稳定量产阶段，衬底等价格已经相对成熟；8英寸SiC MOSFET目前尚在研发验证中，属于工程阶段，其衬底价格尚未稳定。待8英寸产品进入量产后，8英寸量产衬底的价格调整到与6英寸量产衬底价格按照面积的正相关时，8英寸整体的成本优势即会体现出来。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无   |

|    |             |
|----|-------------|
| 日期 | 2024年10月29日 |
|----|-------------|